

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

钜泉光电科技（上海）股份有限公司为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，维护公司全体股东利益，公司于 2026 年 4 月 30 日发布《2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称“行动方案”），为公司 2026 年度提质增效重回报行动明确了工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，2026 年上半年行动方案主要举措的落实（进展）及成效情况具体如下：

一、聚焦主营业务发展，持续提升核心竞争力

报告期内，公司紧密围绕 2026 年度经营目标，把握新型电力系统建设窗口期，主动应对行业标准升级与市场环境变化，持续强化核心技术攻关与新产品研发。在稳固智能电网芯片现有市场份额基础上，抢抓新能源、海外电力基础设施建设市场机遇，大力推进 BMS 芯片等新兴业务拓展，持续培育新增长动能，通过精细化运营与产品创新持续改善经营质量，全力推动企业稳健发展。

1、技术研发与产品创新

公司始终坚持 Fabless 模式，以技术创新为核心驱动力。2026 年上半年，公司研发投入持续保持高强度，研发投入达 9,132.58 万元，同比增长 0.63%，持续保持行业领先的研发强度。公司紧跟国家新型智能电网建设需求，围绕核心产品三大品类推进技术迭代。截至 2026 年 6 月 30 日，公司研发团队规模达 221 人，占总员工数的 79.78%，充分彰显了公司对研发工作的高度重视。报告期内，公司新申请专利及软件著作权共 10 项（含发明专利 9 项），获得专利授权 2 项。报告期内高强度的研发投入不仅巩固了公司在细分领域的技术领先优势，更为未来产品创新和市场拓展奠定了坚实基础。

（1）电能计量芯片

报告期内，公司依据客户需求持续对相关芯片进行迭代更新，稳步推进智能电网专用芯片的技术研发与创新。目前产品已覆盖智能电网用电、配电领域，广泛服务于计量、测量、保护、控制等多个应用场景。

作为公司传统优势业务，2026 年公司持续优化计量芯片的精度与可靠性，进一步巩固国内市场领先地位。针对国南网新企标要求，公司完成了支持基波无功计量的单相计量芯片的升级迭代，目前已达量产并开始交货。带端子测温功能的单相计量芯片已在海外市场取得应用突破，进入小批量生产阶段。基于 IIF 的单相计量芯片进入验证阶段。新一代全功能单相计量芯片在研发中。

（2）智能电表 MCU 芯片

公司自主研发的 MCU 产品线已在国网、南网及海外高端智能表计市场获得广泛应用，并持续推进技术升级，积极布局未来双芯模组化智能电表的市场需求。

报告期内，公司有序推进 MCU 产品线的技术迭代升级。目前在研的新一代高算力安全 AI MCU 芯片，集成高性能 32 位内核与 NPU，配备 1MB Flash 及 1MB RAM，主频可达 200MHz 以上，并具备安全加密功能。该产品基于 40nm 工艺平台开发，符合车规级应用标准，将显著提升智能表计的数据处理能力与安全性，适用于未来电表的端侧 AI 应用场景。针对国南网三相 MCU，公司研发了基于 40nm 工艺的新一代 MCU，flash 支持 ECC 功能，算力更高，内存资源更大。此外，基于 RISC-V 架构的芯片已进入客户送样阶段，产品算力与内存资源较上一代大幅提升，重点面向海外高端表计市场。

单相 SoC 针对独立 RTC 供电，PSA1 级等做了迭代更新，目前处于研发阶段。三相 SoC 芯片迎来重大升级，算力、存储资源及计量精度均得到显著提升，同时新增支持 SAR ADC、CAN 总线等功能接口，可广泛应用于用电、配网及新能源等领域，目前已进入量产阶段。

负荷辨识和故障电弧方面，公司对算法和数据进行了平台建设，可适用于公司不同芯片平台。目前依托已有的三相 SoC 做了基础的负荷辨识应用，未来会针对在研的 AI MCU 做更高级应用。

（3）载波通信芯片

报告期内，公司已完成满足南网新一代标准的 HDC（高速双模）芯片的流片和模块送样检测工作，本次送检共有 8 家表厂采用我司新标准方案，所有类型模块均

满分通过。满足国网新一代标准的 HDC（高速双模）芯片正在进行设计，即将流片。国/南网新一代标准的芯片产品在通信速率和稳定性上有所提升，有望进一步巩固公司在电力线通信领域的市场份额

在市场拓展方面，公司持续深化“芯片+方案”的合作模式，通过战略合作实现技术资源与市场资源的深度对接，重点布局国/南网新一代标准 HPLC+HRF 双模通信芯片，以及海外 G3-Hybrid 双模通信芯片。南网市场，公司继续保持极高的首次送检通过率，并以灵活的合作模式以及较敏捷的售后响应进一步扩大客户群；在国网市场，随着各省网招标对芯片原厂资质审核加严，市场竞争格局将发生深刻变化，整体有利提升我司方案中标概率；海外电网市场，G3-PLC 单/双模芯片受国际品牌芯片厂策略调整影响以及国内表厂国产化需求的升级，叠加公司模组定制化能力的增强，市场占有率快速提升。2026 年，公司 G3-PLC 单/双模芯片销量同比大幅增加，另外，芯片推广方面也进展快速，已成功覆盖绝大部分主流出口表厂，仅有一家头部表厂还处于评估状态。在 HPLC+RF 双模通信芯片应用领域，公司芯片所采用的 RF 频段可满足海外地区相关合规要求，已率先在中亚地区实现规模化商用，处于行业领先水平。此外，公司依托成熟的协议栈技术底座，针对海外电网停电频发、线路串扰严重等应用痛点，进一步优化了多网络协同共存机制与台区节点入网锁定技术，显著提升了产品在复杂现场环境下的运行可靠性，为与下游多家头部电表企业开展深度合作及产品导入奠定了坚实基础。

（4）BMS 芯片

作为公司重点培育的新增长引擎，2026 年上半年加速技术落地，完成工业级 BMS AFE 芯片量产，并获得电动二轮车客户批量订单，同时与新能源汽车、工商业储能领域客户开展技术对接。该品类处于市场拓展初期，尚未形成规模收入，但技术进展顺利，为 2026 年及未来业绩增长提供重要支撑。

报告期内，BMS 芯片研发继续取得重要突破，HT32F208 系列芯片在原有基础上进行了功能优化和技术更新，主要应用于吸尘器、洗地机等清洁电器、电动工具、户外电源和充电宝等产品电池的计量和管理，并已于 2025 年第三季度开始导入清洁电器市场的主要客户产品中，目前已实现批量量产。

BMS 除了大力推广成熟产品导入量产外，还投入了大量研发成本在提升优化 ADC 精度、带隙参考基准精度和 isospi 隔离通信技术。报告期内，公司研发的最高

功能安全 ASIL-D 的高精度汽车级电池监控芯片处于内部验证中，可测量多达 18 节串联的电池组；同时公司在去年成功申报的上海汽车芯片产业联盟的车规 EBS 传感器芯片的揭榜挂帅项目，目前正在处于研发中。

2、深化供应链精益管控，筑牢稳健低成本生产保障体系

公司采用 Fabless 轻资产模式，专注芯片设计，晶圆制造、封装测试环节全部采用委外合作模式。现阶段供应链管理围绕供给稳定、成本压降、品质严控三大目标持续落地优化。公司维持与和舰科技、华天科技、通富微电、长电科技等行业头部晶圆代工、封测企业的长期深度战略合作，持续深化常态化沟通联动机制。

2026 年上半年，受成熟制程产能供需格局影响，上游晶圆代工价格震荡上行。面对上游成本上涨压力，公司持续加大与核心供应商的议价力度，深化长期协议产能绑定、统筹排产调度，对冲行业供需阶段性变动带来的供货波动与成本上行风险。一方面依托集中集采、批量下单模式争取更优采购条件，结合芯片架构、制造工艺迭代优化持续压缩单颗芯片制造成本；另一方面延续年度框架协议签约模式，提前锁定核心晶圆、封装产能与采购基准，最大限度平抑价格波动冲击，守住成本底线。同时公司不断提升芯片集成化设计水平，以硬件集成简化后端加工工序，持续优化单位生产成本，进一步放大产品价格优势与市场竞争力。

精细化供应链运营体系，有效保障现有量产产品稳定交付，同时支撑新一代芯片研发迭代，为公司业务持续拓展提供可靠生产支撑。

3、国内外市场双线推进，海外市场抢抓增长机遇

报告期内，公司持续巩固与国内电网领域核心客户的战略合作关系，在国网、南网等主要市场保持技术领先优势和稳定的市场份额。国内智能电表市场处于招标周期调整期，国网、南网招标量虽保持稳定，但交付节奏放缓，导致下游表厂库存消化周期延长。受此影响，尽管传统业务面临阶段性压力，公司的双模通信芯片仍在南网招标中保持较强竞争力，为整体经营业绩提供了有力支撑。

海外市场方面，公司抢抓全球智能电网改造升级带来的增长机遇，海外业务主要依托国内电表制造合作伙伴，采取“技术+市场”协同出海模式，报告期内双模通信芯片已在中亚地区实现规模化商用，产品逐步向东南亚、东欧、非洲等新兴电网市场渗透。针对海外不同区域电网标准、通信协议差异，公司持续推进适配海外市

场的芯片产品迭代，完善产品定制化方案，夯实海外拓展的产品基础。未来公司将持续挖掘海外市场机会，稳步提升海外市场的产品渗透率。

二、优化运营管理，全力推进降本增效

1、优化管理架构，完善人才梯队建设

报告期内，公司严格落实年度人才建设专项部署，持续完善“引育用留”全链条人才管理体系。围绕电力芯片设计、储能 BMS、车规级芯片等核心战略领域，精准梳理关键岗位人才需求，依托校园招聘、社会招聘、高端猎聘、校企合作多元渠道开展引才工作，持续优化研发、营销、管理全员人才结构，夯实公司战略发展人才支撑。同时，公司优化内部人才培养与激励机制，畅通晋升通道，强化核心人才留存，有效提升团队凝聚力与整体战斗力。

2、强化供应链管控，构建安全高效的生产保障体系

报告期内，公司稳步推进运营数字化、精益化、智能化升级，聚焦提质降本、提效保供核心目标，持续完善质量管理体系，落地国网标准专项质量管控机制，实现芯片设计、流片、封测、量产全流程质量闭环管控，有效保障产品核心性能与运行稳定性。生产供应链端，公司持续深化与核心晶圆厂、封测厂的战略合作，通过长期协议、集中采购、联合研发等模式压降综合成本；持续推行精益生产与制造，优化生产工艺，稳步提升产品良品率与订单交付效率，顺利保障国南网批量招标及紧急订单交付需求。

3、加强财务管理，实现资金安全与效率的平衡

报告期内，公司全面推进研发、采购、销售全流程精细化成本管控，聚焦原辅材料核心环节深挖降本增效潜力，严控各板块非经营性开支。持续升级全面预算管理体系，推动经营计划与预算管理深度融合，强化科研项目预算全流程管控，细化预算考核标准，有效规范经费使用。同时，优化存货动态管理机制，常态化开展库存梳理、结构分析与呆滞物料盘活，统筹资金收支统筹调度，严守资金安全底线，稳步提升资金使用效率。

三、重视股东回报，共享公司发展成果

公司牢固树立回报股东的意识，重视对投资者的回报，在兼顾公司可持续发展的同时，实施持续稳定的利润分配政策。公司近三年来累计现金红利达 1.69 亿元（含税），占累计归属于上市公司股东净利润的 63.20%。

2026 年公司实施了 2025 年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利 3.00 元，合计派发 3,467.82 万元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 80.91%。

未来，公司将结合资金使用安排、经营发展需要以及业务战略目标，认真研究相关政策，合理提高分红率和股息率，维护广大股东的合法权益，保证公司长期稳健的发展，以实现业绩增长与股东回报的有效平衡，构建可持续发展的股东价值回报体系。

四、提高信息披露质量，强化投资者交流

2026 年上半年，公司严格遵照《证券法》《公司法》及科创板上市规则等法律法规要求，规范开展各项信息披露工作。公司持续健全信息披露内控管理制度，细化披露审核流程，严把信息披露质量关口，确保定期报告、临时公告等各类披露文件真实准确、规范及时，未发生信息披露差错、违规及舆情风险事件，持续保持高质量、规范化的信息披露水平。投资者关系层面，公司持续优化投资者沟通机制，依托上证 E 互动平台、投资者热线、专用邮箱等多元渠道，常态化响应投资者咨询、解答市场关切。积极维护与机构投资者、中小股东的良性互动，有序开展日常投资者交流工作，有效保障全体投资者的合法知情权，持续提升公司资本市场透明度与公信力。

五、持续完善公司治理体系，提升规范运作水平

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立健全各项内控制度，并组织企业内部培训，同时利用监管部门、各级上市公司协会等开设的课程培训董高，及时传递分享政策动态，提升董高履职技能、增加合规知识储备。

2026 年上半年，公司共召开 1 次股东会、1 次董事会、2 次专门委员会。公司独立董事积极履职，通过线上和现场参加会议、实地调研等了解公司。公司管理层定

期向独立董事汇报公司经营情况和重大事项，更充分地发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司持续规范发展。

2026 年上半年，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管规范，持续夯实公司治理基础。报告期内，公司董事会及审计、战略、薪酬与考核、提名各专门委员会规范有序运作，严格履行审议、监督、决策职责，充分发挥专业委员会在风险把控、资金安全、股权激励、绩效考核、合规监督等方面的专业作用，决策科学性与治理规范性持续提升。公司持续动态优化内控制度与业务流程，结合最新监管政策及经营发展实际，完善风险识别、预警及应对机制，常态化开展内部合规自查，有效提升公司经营全流程风险防控能力。同时，公司常态化组织董高及核心技术人员开展合规培训，积极参与监管机构、上市公司协会组织的专项培训，及时更新政策储备、夯实合规履职能力，强化关键少数责任意识与规范运作理念，保障公司治理机制高效、合规运转。

六、其他说明

2026 年下半年，公司将积极落实 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主营业务，提升公司经营管理水平、核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的经营管理、规范的公司治理、及时的信息披露，积极回馈投资者的关注与信任，履行上市公司责任和义务，切实保护投资者利益，进一步维护公司资本市场的形象。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日